

## 貝克微 (2149)

開始認購日期	2023年12月18日
截止認購日期	2023年12月21日上午
公開發售結果	2023年12月27日
上市日期	2023年12月28日
保薦人	中金公司

集團概要:	
公開發售價	\$27.47-38.45 元
市值	\$1,650-2,310 百萬港元
行業	半導體
全球發行股數	15,000,000
集資總額	\$576.8 百萬(HK \$38.45 計算)
香港發售股份佔比	10.0%
每手入場費	\$3,883.78 港元

### 集團簡介:

集團是於中國享有重要市場地位的模擬 IC 圖案晶圓提供商之一。集團可交付的產品是附著完整電路、下游客戶可自行決定通過標準易行的封裝測試或使用集團提供的封裝測試解決方案後即可製成單個 IC 芯片的模擬 IC 圖案晶圓。以 2022 年收入計，集團是中國最大的模擬 IC 圖案晶圓提供商，佔同年中國市場規模總額的市場份額為 1.7%。

### 行業現況

集成電路是一種微型電子設備或組件，是全球信息技術產業的基本構件和核心組件。預計未來幾年，隨著以 5G、物聯網和雲計算為代表的新技术的推廣，到 2027 年，中國 IC 市場的市場規模預計將達到人民幣 21,966 億元，自 2022 年至 2027 年的年複合增長率為 9.5%。隨著全球 IC 市場向中國轉移，以及中國國家政策和資金的大力支持，中國 IC 行業的市場份額已佔全球 IC 市場的很大一部分，由 2018 年的 38.2% 增至 2022 年的 41.5%，預計於 2027 年將達到 44.5%。中國的 IC 分銷商市場高度分散，以 2022 年收入計，前十大市場參與者所佔份額約為 6.0%。

### 經國農證券認購截止日期

2023 年 12 月 20 日 3pm

### 經國農證券認購手續費

現金全數認購	一律 \$0 手續費
孖展融資認購	\$100 手續費
融資借貸日數	1 日

### 行業風險

集團未來的成功在很大程度上取決於集團繼續創新和改進現有產品以及設計和擴展產品組合的能力。產品設計、開發、創新和迭代往往是一個複雜、耗時且成本高昂的過程，涉及大量的研發投資，且無法保證投資回報。概不保證集團將能夠及時或有效地開發和推出新的和改進的產品，或者新的和改進的產品將獲得市場認可任何無法滿足下游客戶的質量和可靠性標準或未能遵守行業標準和技術要求的行為都可能對集團的產品需求和經營業績產生不利影響。

### 主要財務數據：

(人民幣千元)	2021	2022
收入	212,711	352,510
銷售成本	(92,711)	(153,186)
毛利	120,000	199,324
除稅前溢利	56,969	96,824
淨溢利	56,969	95,262

集資用途	(百分比)
用於提升研發及創新能力	30%
用於進一步豐富貝克微電子的產品組合及拓展貝克微電子的業務	30%
用於戰略性投資及收購，以實現貝克微電子的長期增長戰略	20%

### 主要股東

股東名稱	持股百分比(%)
蘇州貝克瓦特電子有限公司	14.59%